

# 中国电子材料行业协会覆铜板材料分会

## 关于召开“2024年中国覆铜板行业高层论坛”的通知

中国电子材料行业协会覆铜板材料分会，拟定于2024年5月8日至10日在广东省梅州市“梅州迎宾大酒店”，召开“2024年中国覆铜板行业高层论坛”。

当前，国际环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，俄乌冲突持续、巴以战争升级、地缘冲突此起彼伏，多重危机对全球经济构成叠加冲击；国内有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱。面对新形势，我国覆铜板行业如何贯彻“稳中求进、以进促稳、先立后破”的国家经济发展总基调，覆铜板产业如何创新开拓、如何抓住机遇，使产业实现质的有效提升和量的合理增长，稳步推进覆铜板产业高质量可持续发展。值此之际，举行“中国覆铜板行业高层论坛”具有重大的现实意义。会议主题为“**凝心聚力迎挑战 开拓创新赢未来**”，将邀请上级主管部门领导、覆铜板行业及上游原材料、下游PCB行业著名专家、企业家围绕大会主题，从产业链与宏观经济、新市场及新技术等多维度，对2024年及未来覆铜板产业发展趋势进行研判。

“2024年中国覆铜板行业高层论坛”由中国电子材料行业协会覆铜板材料分会主办，广东龙宇新材料有限公司承办。热忱欢迎业界同仁莅临会议进行交流与研讨。

现将会议有关事项通知如下：

一、**主办单位**：中国电子材料行业协会覆铜板材料分会（CCLA）

二、**承办单位**：广东龙宇新材料有限公司

三、**赞助单位**：

广东龙宇新材料有限公司

诺德新材料股份有限公司

浙江华正新材料股份有限公司

南通凯迪自动机械有限公司

南亚新材料科技股份有限公司

同宇新材料（广东）股份有限公司

建滔积层板控股有限公司  
山东圣泉电子材料有限公司  
南通图海机械有限公司  
浙江双元科技股份有限公司  
浙江花园新能源股份有限公司  
咸阳威迪机电科技有限公司  
广东盈华电子材料有限公司  
彤程新材料集团股份有限公司  
广东东南科创科技有限公司  
华烁电子材料（武汉）有限公司  
广东生益科技股份有限公司  
成都科宜高分子科技有限公司  
诺泽流体科技（上海）有限公司  
广东亚镭环境科技股份有限公司  
无锡伟一不锈钢有限公司  
珠海镇东有限公司  
江苏东材新材料有限责任公司  
苏州巨峰新材料科技有限公司  
深圳市环宇昌电子有限公司  
汕头超声覆铜板科技有限公司  
杭州惠正智能科技有限公司  
梅州市威利邦电子科技有限公司  
无锡赫普轻工设备技术有限公司  
东营市赫邦化工有限公司  
武汉意普科技有限责任公司  
陕西宝昱科技工业股份有限公司  
苏州锦艺新材料科技股份有限公司  
中国巨石股份有限公司  
江西省航宇新材料股份有限公司  
合肥井松智能科技股份有限公司

淮北绿洲新材料有限责任公司  
广州源鼎电子科技有限公司  
中国石化化工销售有限公司华中分公司  
•••••

**四、会议日期：**“2024 年中国覆铜板行业高层论坛”会期：2024 年 5 月 8 日~10 日。5 月 8 日，全天报到；5 月 9 日，会议报告：8:30~16:30，参观广东龙宇新材料有限公司：16:30~18:00；5 月 10 日，代表疏散。

**五、会议会址：**酒店名称：梅州迎宾大酒店 地址：梅州梅江区彬芳大道南 88 号

**六、会议日程（附后）**

**七、会议费用：**

**费用包括：**会务费、资料费、餐饮费等。会员单位代表：已交会员费单位为 1500 元/人；未交会员费单位、非会员单位代表为 2000 元/人。

参会代表可提前将会务费用汇至协会账户，如参会人员有变动，可随后退费或报到现场补交。住宿：参会代表按会议优惠价提前自行与酒店联系预定房间。标间 378 元/晚/间（含双早），单间：378 元/晚/间（含双早），费用自理。

**预定住宿联系人：张珊珊 13549170667**

**参会代表预先付款方式：**

**帐 户：**中国电子材料行业协会

**开户银行：**工行北京香河园支行

**账 号：**0200 0191 0900 0125 724

注：提前汇款请在汇款之日将开票信息同会议回执一起发给会务组，收到汇款后即可开票邮寄，汇款时请附言“覆铜板会议会务费”，以便区分；现场现金缴费的请将开票信息同会议回执一起提前发到会务组，以便及时开票。

**八、交通指南：**

**揭阳潮汕国际机场：**距离会议酒店约 125 公里，乘车约 1 小时 30 分钟到达；

**梅州机场：**距离会议酒店约 3 公里，乘车约 10 分钟到达；

**梅州西站（高铁站）：**距离会议酒店约 12 公里，乘车约 20 分钟到达；

**梅州站（火车站）：**距离会议酒店约 1.2 公里，乘车约 5 分钟到达；

**自 驾：**城南高速路口距离会议酒店 3 公里，约 10 分钟到达，酒店免费停车。

九、其他事项： 请所有参会代表务必将回执在 4 月 30 日前发回秘书处。

### 十、联系方式

CCLA 秘书处联系方式：

联系人：王晓艳 13609146084 15667246308（协会微信）

联系电话：029-33335234 电子邮箱：ccla33335234@163.com

承办单位联系方式：

广东龙宇新材料有限公司 负责人： 陈祖贤 13923030558

中国电子材料行业协会覆铜板材料分会

2024 年 3 月 1 日

## 会议回执

单位名称					
代表姓名	职务	手机	电话	E-mail	高铁/飞机 车次/航班
是否在“梅州迎宾大酒店”住宿？是（ ）/否（ ），已于（ ）月（ ）日预订了单人房（ ）间 双人房（ ）间。					
开票信息：名称： 纳税人识别号： 地址、电话： 开户行及账号：					
注意	1、因房源有限，需要在“梅州迎宾大酒店”住宿的代表，请尽快自行与酒店联系预订房间，与酒店联系时请报覆铜板行业协会，即可享受优惠价格。酒店预定房间联系人：张珊珊 13549170667 2、请参会代表准确填写回执表各项信息，将回执于 4 月 30 日前发至 ccla33335234@163.com。				

# 会议日程

时间	会议内容	地点	主持/负责人
5月8日	全天代表报到	酒店大堂	会务组
5月9日 8:30 ~12:00	主持人介绍参会领导及嘉宾	三楼 果满园厅	董榜旗
	中电材协覆铜板材料分会 理事长 郭江程 致开幕词		
	广东省梅州市人民政府 副市长 蒋鲲 致词、招商推介		
	中国电子材料行业协会 理事长 潘林 致词		
	广东龙宇新材料有限公司 董事长 陈建新 致欢迎词		
	中国电子材料行业协会 理事长 潘林 数字经济时代电子材料发展新机遇新挑战		
	广东生益科技股份有限公司 董事长、CCLA 高级顾问 刘述峰 直面困难、认清形势、高质发展		
	广东省电路板行业协会、深圳市线路板行业协会 秘书长 CCLA 高级顾问 辛国胜 发展中的电路板产业		
	山东圣泉电子材料有限公司 总经理 唐爱云 高性能树脂助力覆铜板行业高质量发展		
	浙江双元科技股份有限公司 副总经理 巴大明 AI 测控在覆铜板制程中的应用		
12:00 ~ 13:30	午餐	二楼 西餐厅	王晓艳
5月9日 13:30 ~16:30	浙江花园新能源股份有限公司杭州研究院院长、浙江大学材料科学与工程学院 副教授 谷长栋 高精密宽幅压延厚铜箔产品研发及应用推广	三楼 果满园厅	董榜旗
	广东龙宇新材料有限公司 技术总监 胡昕 厚铜覆铜板在 PCB 的应用		
	中电材协副秘书长、电子铜箔材料分会 秘书长 冷大光 2023 年我国电子铜箔行业经营状况及未来展望		
	河南光远新材料股份有限公司总经理 宁祥春 中国大陆电子玻纤现状及高性能电子玻纤的发展趋势		
	中国电子材料行业协会覆铜板材料分会 秘书长 董榜旗 2023 年中国覆铜板行业调查解析		
中国电子材料行业协会覆铜板材料分会 高级顾问 师剑英 如何解决环氧树脂在高性能覆铜板中的应用			
5月9日 16:30 ~18:00	参观广东龙宇新材料有限公司	开发区 工厂	邓丽
5月9日 18:30 ~20:00	广东龙宇新材料有限公司 招待晚宴	三楼 果满园厅	甘静
5月10日	代表疏散		

承办单位：广东龙宇新材料有限公司

会务负责人：陈祖贤 13923030558

会务联系人：甘静 13823892567